

2024 年度第 2 四半期決算説明会（2024 年 10 月 31 日開催）

QA 要旨

Q1. 今後の更なる成長に向けて、先端技術分野への投資を拡大していくとの説明でしたが、具体的にどのような技術に重点的に投資していくのでしょうか。

A1. 現在、チップレットと組み合わせた 2nm のテストチップの開発を進めていますが、更なるプロセスの微細化に取り組んでいきたいと考えています。また、先端パッケージ技術の導入や、市場拡大が期待される新規アプリケーションなど、お客様との連携強化により新しい適用領域の開拓を進めていきます。また、ソリューション SoC 設計技術を更に強化していきます。既に実績のあるチップレットの高信頼性実装に向けた設計技術、特にテスト、熱解析、およびチップ内解析技術の更なる強化や EDA ベンダと連携した設計のフロント・エンド / バック・エンド工程での AI 技術の活用を進めています。

Q2. 最近、自動車市場の悪化が懸念されていますが、御社の製品ですでに量産されているものについては、その影響が出ているのでしょうか。また、開発中の製品については、開発スケジュールの延伸や案件のキャンセルなどは出ていないのでしょうか。

A2. 自動車向けの量産中の製品については、お客様により多少状況は異なりますが、市況の影響を大きく受けてはならず、対前年や今年度の当初見通しから見ても大きな変化は出ていません。また、開発中の製品については、まだ見極めは必要だと思っておりますが、開発時期や量産時期の延伸や量産時の数量が減る可能性があるお客様もある一方、量産時期の前倒しや数量の増加をしたいというお客様もあります。また、自動車用の HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）の製品については、キャンセルは今のところ出ていないので、今後の動向は注意して行く必要はあると思っておりますが、今のところ総じて言えば大きな影響はないと考えています。

Q3. 今年度の売上について、データセンター・ネットワーク分野では、昨年度から特需の終了による売上の減少は想定されていましたが、それに加えて中国通信関係などの中国需要の減少による影響も織り込んでいるとの説明でした。今年度から来年度にかけて、この影響をどう見えていますか。

A3. 2023 年度から 2024、2025 年度は売上水準が下がる主たる要因として、中国通信関係などの中国需要を厳しく見ていることがあります。特需の終了による売上減の影響は以前から説明していましたが、特需製品の通常売上分やその他の製品も弱含みで推移すると見えています。その背景として、中国の経済状況や通信関係の設備投資動向、さらには個別のお客様の在庫状況などが複合的に影響しているものと考えています。

Q4. 営業利益率の推移と見通しについて、今年度から来年度にかけて若干下がる見通しとの説明でしたが、製品粗利率が今年度から下がる要因を教えてください。

A4. 製品粗利率について、今年度は、製品構成の変化や調達に係る原価の間接的な為替影響で前年度より改善する見込みです。来年度は、調達に係る原価の間接的な為替影響の減少が予想されることや新規量産品の立上げなどの製品構成の変化もあり、今年度に比べ下がる見込んでいます。

Q5. 2024 年度通期売上予想について、当初見通し比（対 4 月時点予想比）での製品売上の増減、特にデータセンター/ネットワーク向けについては、すでに上期で影響が出ているのか、下期で出ると見ているのか教えてください。

A5. 当初見通し比では、上期、下期でそれぞれ出ると見込んでいますが、下期の方が影響が大きいと見えています。

Q6. 特需関連の製品は、昨年度の売上がピークとなり今年度、来年度と減少していくのではないかと思います。御社はどのように見えていますか。

A6. この製品については、これまでに需要の前倒しもあり、今年度から来年度にかけて徐々に減少し終了するものと見ていましたが、もう少し続く可能性もあると思います。また、通信関係の商品サイクルもグローバルにみても長くなる傾向があり、収益は減少するものの、製品寿命も想定より長くなるかもしれません。

Q7. 中国通信関係向けで、特需関連の製品以外のその他の製品とは、どのような製品でしょうか。

A7. 有線関連向けの製品などいくつかの種類があります。それぞれの売上規模はあまり大きくはありませんが、トータルの売上は減少しています。

Q8. 北米のデータセンター向けの案件について、前回の説明会では、まだ正式な商談契約前の状況との説明でしたが、その後の進捗を教えてください。

A8. 第2四半期末までに、正式契約を完了し、社内基準に則り新規商談獲得の案件としています。実質的な開発はすでに第1四半期より始まっており、今後の開発期間を経て2026年度からの量産開始を期待しています。

Q9. この北米データセンター向けの商談を獲得したことにより、この分野でのビジネスの拡大が期待できるのでしょうか。

A9. この分野では、先端技術を使ったソリューション SoC の需要が拡大しており、今後この分野での商談獲得を増やしていきたいと考えています。現在お話しするような具体的な案件はありませんが、今後も先端技術分野への投資を拡大し、今回の北米データセンター向け商談をきっかけにこの分野での実績を拡大していきたいと思えます。

Q10. 上期のプロセスノード別の NRE 売上を見ると、3nm-7nm の比率が8割以上と大きな割合を占めていますが、どのプロセスノードの製品が多いのでしょうか。またこれらのプロセスノードの製品をアプリケーションや地域別にみるとどうなりますか。

A10. 3nm と 5nm を合わせて全体の過半を占める状況です。アプリケーション別では、3nm は自動車とデータセンター向け、5nm は様々なアプリケーション向けがありますが、自動車向けが一番多い状況です。地域別に見ると、これらの先端プロセスノードの製品は、アメリカ向けの比率が最も大きく、次いで中国や日本向けが続く状況です。

Q11. 今年度の商談獲得金額について、昨年度の 2,500 億円以上を目指すとのことですが、上期の進捗を見るとデータセンター・ネットワーク向けが過半を占めるとの説明でした。昨年度は自動車向けが多かったと思いますが、今年度は自動車向けの商談が減少しているのでしょうか。

A11. 自動車メーカーで、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)用のカスタム SoC を自社で持とうとされているメーカーは、自社開発されている会社を除くと、その多くは当社と取引があるのではないかと思います。これらのお客様向けには、現在量産に向けて開発が進んでおり、新規商談という意味では次世代製品までの端境期にあたるのではないかと考えています。グローバルに見ると、チップを自社開発しようという動きは拡大していくと考えており、重点分野として当社の強みを活かし、ビジネスの拡大をはかっていきたいと考えています。

以上